날개형 핀-휜의 기하학적 형상이 전자기기 모듈 냉각용 공기냉각기의 유동 및 열전달에 미치는 영향

김수연^{*}, 허 견[†], 신석원

*영남대학교 공과대학 기계공학부 712-749 경북 경산시 대동 214-1

[†]에너지관리공단 706-722 대구광역시 수성구 범어2동 45-5

(2008년 11월 21일 접수; 2008년 12월 11일 수정본 접수; 2008년 12월 12일 채택)

Numerical Analysis of Heat Transfer of Aligned Wing Type Pin-Fin Array of Air Cooling Module with Various Fin Shapes for Electronic Packaging Application

Soo-Youn Kim,* Kyeon Heo,[†] and Seok-Won Shin

School of Mechanical Engineering, Yeungnam University, 214-1 Dae-dong, Gyeongsan, Gyeongbuk 712-749, Korea

[†]Korea Energy Management Corporation 45-5 Beomeo-2-dong, Suseong-gu, Daegu 706-722, Korea (Received for review November 21, 2008, Revision received December 11, 2008; Accepted December 12, 2008)

요 약

본 연구는 전자기기 모듈의 공기 냉각용 정렬 배열된 핀·휜 열교환기에서 흰 형상의 변화가 유동 및 열전달에 미치는 영향을 수치적으로 해석하였다. 휜 단면의 기하학적 형상은 세 가지로서 원형, 타원형, 그리고 날개형이 었다. 취급된 모든 휜의 단면적과 높이는 서로 동일하지만, 그 표면적만은 서로 달랐다. 그 결과, 휜의 표면적, 열전달계수, 그리고 열전달 성능은 흰의 형상에 크게 의존하였다. 적절한 형상을 갖는 휜의 열전달 성능은 세 가지 형태의 핀·휜 중에서 날개형 핀·휜이 가장 우수하였다. 이러한 결과로부터 공기의 유량증가 혹은 휜의 밀도증 가 없이 적절한 핀·휜의 형상변화만으로도 핀·휜 열교환기의 냉각성능을 크게 향상 시킬 수 있음을 알 수 있었다.

주제어 : 공랭, 휜 형상, 열전달, 날개형 휜

Abstract : In this study, the flow and heat transfer of the aligned pin-fin array of the air cooling module for electronic packaging application were numerically analyzed with various fin shapes. The geometric cross-sectional shapes of pin-fins considered in this study were ellipse, wing and circle. The fins had same cross-sectional area and height, but they had different surface areas. As the results, the surface area, the heat transfer coefficient, and the heat transfer performance of pin-fins greatly depended on their shapes. Of the three types of pin-fins, the wing type pin-fin with suitable shape produced the best heat transfer performance. This result implies that the cooling capacity of the pin-fin cooler can be significantly enhanced only by the change of fin shape without increasing air flow-rate or fin density.

Key words : Air cooling, Fin shape, Heat transfer, Wing type fin

* To whom correspondence should be addressed. E-mail: sookim@ynu.ac.kr

1. 서 론

고집적화 및 소형화가 진행된 고성능 전자기기의 경우, 고 집적화와 소형화로 인하여 칩이 집적된 모듈의 단위면적당 열 발생율은 필연적으로 증가하게 된다. 또한 국부적으로 매우 높은 열발생율이 나타날 수 있고, 이것은 기존의 공기냉각장 치의 처리 한계를 넘어서는 정도가 되고 있는 실정이다. 이에 따라 이들 전자기기에 발생되는 다량의 열을 효율적으로 제 거하고, 동시에 냉각에 소요되는 에너지를 절감하는 냉각기술 이 중요한 기술적 과제가 되고 있다[1-3]. 전자기기의 냉각에 널리 사용되는 것은 공랭식 핀-휜(pin-fin) 열교환기이다. 핀-휜 열교환기는 발열체 위에 베이스판이 접촉하고, 그 위에 다수의 휜(fin)들이 부착된 형태를 가지고 있다. 핀-휜 열교환기에서 휜 과 관련한 연구들을 살펴보면, Razelos and Satyaprakash[4] 는 사다리꼴 휜에 대하여, Nakazato at al.[5]은 휜의 경사각 도에 따른 열전달 특성을 실험과 이론적 해석하였다. Morrison, at al[6]은 휜의 두께가 열전달 특성에 미치는 영향을 조사하 여 최적의 휜 두께와 휜 간격을 제시하였다.

한편 기존의 핀-휜에 비하여 유동저항은 훨씬 적으면서도 열 전달 성능은 오히려 더 높은 새로운 형태의 것으로 Figure 1에 서 보는 것과 같은 날개형(wing type) 핀-휜이 최근 사용되기 시작하고 있다. 그림에서 보듯이 이 핀-휜은 그 단면형상이 날 개형이다. 이것에 대한 연구는 이제 시작 단계에 있으며, 현재 연구자의 수나 발표된 연구결과는 매우 적은 실정이다.

핀-휜 열교환기의 성능은 방열부에 부착된 핀-휜의 열전달 능력에 크게 의존한다. 그리고 핀-휜 주위의 공기유동과 열전 달에 가장 큰 영향을 미치는 것은 휜의 기하학적 형상이다. 그 러므로 적절한 기하학적 형상과 크기를 가진 핀-휜으로 열교환 기를 만든다면 그 성능을 크게 증가시킬 수 있을 것이다.





(a) aligned array

(b) staggered array

Figure 1. Wing type pin-fin heat exchangers.

따라서 본 연구에서는 정렬 배열된 날개형 핀-휜 열교환기 에서 휜의 형상변화가 유동과 열전달에 미치는 영향을 수치적 으로 살펴보고자 한다. 그 결과를 정렬배열 된 기존의 원형 (circle type) 및 타원형(ellipse type) 핀-휜의 결과들과 서로 비교하고, 최적의 휜 형상도 탐색하고자 한다. 그리고 본 연구 를 통해 날개형 핀-휜 열교환기의 설계와 제작에 필요한 기하 학적 변수에 따른 성능자료도 축적될 것이다.

2. 수치모사

2.1. 핀-휜의 형상

본 연구는 정렬로 배열된 핀-휜 열교환기에서 핀-휜의 형상 이 유동 및 열전달에 미치는 영향을 수치적으로 살펴보는 것 이다. 단면의 형상은 단면의 길이와 두께의 함수에 의해 결정 된다. Figure 2는 두께의 변화에 따른 다양한 휜 단면 형상의 변화를 보여준다. 그러므로 그 함수를 적절히 선택함으로써 날개형 혹은 타원형 핀-휜의 다양한 형상을 얻을 수 있다. 그 림에서 보듯이 원형 단면은 날개형 단면과 타원형 단면에서 길이와 두께가 같은 특별한 경우로 볼 수 있다.



(a) wing type pin-fin

(b) ellipse type pin-fin



본 연구에서 휜의 형상이 변함에 따라 모든 휜들의 높이와 단면적은 서로 동일하고, 당연히 부피도 서로 동일하지만, 그 표면적만은 서로 다르다.

2.2. 수치계산

Figure 1에서 보듯이 실제 핀-휜 열교환기들은 많은 수의 정 렬배열 혹은 어긋난 배열의 휜배열로 구성되어 있다. 본 연구에 서는 이러한 실제 핀-휜 배열을 고려하여 적절한 크기의 핀-휜 배열을 선택하였다. 수치해석에 사용된 모델은 Figure 3에서 보는 바와 같고, 소형 풍동 내의 적절한 곳에 핀-휜이 정렬로 배



Figure 3. Schematic diagram of a test model of aligned pin-fin array.

열되어 있다. 핀-휜의 배열은 5×3정렬배열이며, 전후와 좌우의 휜 사이의 간격은 원형 핀-휜의 지름을 기준으로 정하였다. 3차원 정상상태의 열 및 유동특성을 지배하는 지배방정식

을 보면, 우선 연속방정식은 다음과 같다.

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j) = 0 \tag{1}$$

여기서 ρ와 u_j 는 유체의 밀도와 속도성분이다. 그리고 운동량 방정식은 다음 식과 같다.

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu_{eff} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right] - \frac{\partial p}{\partial x_i}$$
(2)

식(2)에서 레이놀즈수가 작은 경우 유효점성계수 μ_{eff} 는 다음 과 같이 정의된다.

$$\mu_{eff} = \mu_{mol} \left[1 + \sqrt{\frac{C_{\mu}}{\mu_{mol}} \frac{\kappa}{\sqrt{\epsilon}}} \right]^2$$
(3)

여기서 μ_{mol} 는 분자점성계수이다. 레이놀즈수가 큰 경우 난류 점성계수는 다음 식과 같이 정의된다.

$$\mu_t = \rho C_{\mu} \frac{\kappa^2}{\epsilon} \tag{4}$$

에너지방정식은 다음 식과 같고,

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i h) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\alpha \mu_{eff} \frac{\partial T}{\partial x_i} \right) + \frac{Dp}{Dt} + (\tau_{ik})_{eff} \frac{\partial u_i}{\partial x_i} + S_h$$
(5)

여기서 α는 난류 Prandtl수이다. 그리고 난류 운동에너지와 소산율 방정식은

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right]$$
(6)

$$+ G_{\!k} + G_{\!b} - \rho \epsilon - Y_{\!M} + S_{\!k}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho\epsilon) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho\epsilon u_i) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_i}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} \right] \\ &+ C_{1\epsilon} \frac{\epsilon}{k} (G_k + C_{3\epsilon} G_b) - C_{2\epsilon} \rho \frac{\epsilon^2}{k} + S_\epsilon \end{aligned}$$
(7)

와 같다. 여기서 G_k와 G_b는 각각 난류응력 및 부력에 한 생성에 너지이다. 위의 식은 표준k-ε난류모델이며, 사용된 계수의 값 들은 C_{1ε}=1.44, C_{2ε}=1.92, Cμ=0.09, σ_k=1.0, σ_ε=1.3 이다. 경계조건을 보면 입구조건은 일정속도와 일정온도를 주었 고, 출구조건은 일정 압력 조건을 주었다. 방열부인 휜의 바닥 면에 일정 열유속 조건을 주었고, 풍동의 벽면은 열전달이 없 는 단열조건과 점착조건을 주었다. 그리고 온도변화에 따른 물성치의 변화는 고려하지 않았다. 따라서 경계조건은 다음과 같다.

$$T = T_{in}, V = V_{in} \quad at \quad x = 0 \tag{8}$$

$$V=0 \qquad at \ all \ walls \tag{9}$$

$$P = 101.3 \, kPa \qquad at \qquad x = L \tag{10}$$

q = 17 W/cm at fin base

$$q=0 \qquad at \quad y=0, \ y=W, \qquad (11)$$
$$z=0 \ (except \ fin \ base), \ z=H$$

본 연구에 사용된 격자의 한 예를 Figure 4에서 볼 수 있다. 그림에서 보듯이 비균일 격자계로서 계산시간을 줄이기 위하 여 유속의 변화가 심할 것으로 예상되는 휜 주위에 격자를 집 중 배치하였다. 그리고 격자수에 대한 계산결과의 의존성을 검 토하고, 그 결과를 토대로 적정 격자수를 결정하였다. 수치계 산에 사용된 프로그램은 그 성능이 잘 검증된 상용 소프트웨어 인 FLUENT6.2[7]이었다. 수렴조건은 residual의 크기가 에 너지방정식에서는 10⁻⁶이내에 나머지 항은 10⁻⁴이내 일 경우 에 수렴하는 것으로 하였다. 작동유체는 일정한 물성치를 갖는 비압축성 공기이고, 복사 효과는 무시되었다. 그리고 수치계산

Table 1. The data used in the numerical calculation

Properties	Air density = 1.225 kg/m^3 $C_P = 1006.43 \text{ J/kgK}$ k = 0.0242 W/mK $\mu = 1.7894e-05 \text{ kg/ms}$ Aluminum density = 2719 kg/m^3 $C_P = 871 \text{ J/kgK}$ k = 202.4 W/mK
Operating conditions	Air velocity = $1 \sim 5$ m/s Air inlet temperature = 297 K
	Heat flux at base = 17 W/cm^2
Wind tunnel	$L \times W \times H = 150 \times 100 \times 60 \text{ (mm)}$
Fin geometry	$H_{f} = 30 \text{ mm (fixed)}$ $A_{c} = 12.57 \text{ mm}^{2}$



Figure 4. Grid generation for a numerical calculation (top view).

에 시용된 운전조건과 물성치는 Table 1과 같다.

3. 결과 및 검토

3.1. 핀의 표면적

대류 열전달을 결정하는 것은 온도차, 열전달계수, 그리고 전열면적이다. 전열면적에 따라 열전달은 단조 중가한다. 따 라서 실제 열교환기들은 전열면적을 중가시키기 위하여 다양 한 형태의 많은 휜들을 사용하고 있다.

Figure 5는 흰 형상이 휜 표면적에 미치는 영향을 표시한 것이다. 그림에서 A^{*},와 t^{*}은 휜 단면 형상이 원형일 때의 휜 표면적과 흰 단면의 지름을 나타낸다. 그림에서 보듯이 휜의 표면적은 두께가 얇아질수록(즉, 휜의 단면 형상이 원형에서 얇은 두께의 타원형 혹은 날개형으로 변할수록) 매우 빠르게 중가한다. 동일한 두께일 때, 날개형 핀-휜의 표면적은 타원형 의 그것보다 더 크다. 표면적은 Eq. 12와 같다. 또한 원형 핀-횐은 날개형과 타원형 흰 중에서 흰 단면의 길이와 그 두께가 같은 특별한 경우로 볼 수 있고, 원형 핀-휜의 표면적이 가장 작다.

$$(As)_{wing} > (As)_{e\,llipse} > (As)_{circle}$$
(12)



Figure 5. The effect of pin-fin shape on surface area.



Figure 6. Flow fields around aligned pin-fin array (inlet air velocity=3 m/s, h=15 mm, t=2.8 mm).

따라서 휜의 표면적, 즉 전열면적을 증대시키는 효과적인 방법 중의 하나는 핀-휜의 단면형상을 두께가 얇은 날개형으로 제작하는 것이다.

3.2. 유동장과 온도장

Figure 6은 정렬 핀-휜 배열 주위의 유동장의 한 예를 보여 준다. 그림에서 보듯이 유동장은 대칭을 이루고, 휜 뒤쪽에 후 류(wake)가 형성되어 있다. 타원형이 날개형에 비하여 휜 주 위의 유동이 더 활발하며, 뒤쪽 후류의 크기와 와류의 세기도 더 크다. 따라서 타원형 흰 표면의 열전달 계수도 더 클 것이 다. 그것은 유동이 활발할수록 대류가 잘 일어나기 때문이다. 하지만 타원형이 날개형에 비하여 유동이 더 활발하기 때문에



Figure 7. Temperature fields around aligned pin-fin array (inlet air velocity=3 m/s, h=15 mm, t=2.8 mm).



Figure 8. The effect of pin-fin shapes on average heat transfer coefficient of aligned pin-fin array (inlet air velocity = 3 m/s, fin height = 30 mm).

압력강하도 더 커질 것이다. 이는 타원형 핀-휜을 사용할 때가 날개형 핀-휜을 사용할 때 보다 동일한 공기량 순환에 대한 압 력강하가 보다 더 클 것이라는 의미한다. 이러한 사실로부터 적절한 휜 형상을 선택할 경우 핀-휜 열교환기 내의 공기순환 에 소요되는 펌프입력을 줄일 수 있음을 알 수 있다.

Figure 7은 열전달의 결과인 휜 배열 주위의 온도장의 한 예를 보여준다. 그림에서 보듯이 앞쪽에 배열된 휜들의 온도 가 뒤쪽의 그것에 비해 더 낮다. 이는 뒤쪽 휜 주위의 공기온 도가 앞쪽 휜 주이의 공기온도에 비하여 더 높고, 앞쪽 휜이 뒤쪽 흰에 비해 열전달계수가 더 큰 것에 기인한다. 그리고 휜 위쪽 부분의 온도가 아래쪽의 그것에 비해 더 낮은데, 이는 휜 베이스로부터 열이 공급되기 때문이다. 전체적으로 볼 때 같 은 위치에 있는 휜들의 온도를 서로 비교해 보면, 날개형 휜의 온도가 타원형 횐의 그것에 비해 더 낮다. 이러한 온도분포는 열전달의 결과이며, 날개형 배열이 타원형 배열에 비해 열전 달 성능이 더 높다는 것을 의미한다.

3.3. 열전달계수

대류열전달에서 열전달계수는 단위 면적당, 단위 온도차당 열전달량을 나타내는 것이며, 본 연구의 그림에 표시된 열전 달계수는 휜 표면의 평균 열전달계수이다.

Figure 8은 정렬 핀-휜 배열에서 휜의 형상의 변화가 평균 열전달계수에 미치는 영향을 보여준다. 여기서 h^{*}는 핀-휜의 단 면형상이 원형일 때 평균열전달계수를 나타내고, x축의 값이 1인 경우는 단면형상이 원형인 경우를 나타낸다.

그림에서 보듯이 동일한 두께일 때 열전달계수는 타원형이 날개형보다 항상 크다. 이것은 3.1절의 유동장 해석에서 언급 한 바와 같이 휜의 단면형상이 타원형인 경우가 날개형인 경 우에 비하여 휜 주위의 유동이 더 활발하기 때문에 나타난 결 과이다.타원형과 날개형의 휜의 두께가 증가함에 따라, 즉 휜 의 형상이 타원형과 날개형에서 원형으로 접근함에 따라 열전 달계수가 증가하고 있다. 이는 휜의 형상이 원형에 접근할수 록 휜 주위의 유동이 활발해지고, 이에 따라 열전달계수도 증



Figure 9. The effect of pin-fin shapes on the heat transfer performance of aligned pin-fin array(inlet air velocity = 3 m/s, fin height = 30 mm).

가하기 때문이다. 따라서 단면형상이 원형인 경우, 휜의 열전 달계수가 가장 크다. 즉, 평균열전달계수는 Eq. 13과 같다.

$$(h)_{cicle} > (h)_{e\,llipse} > (h)_{wing} \tag{13}$$

3.4. 열전달 성능

대류 열전달은 (hAs)×ΔT으로 주어지기 때문에 열전달 성능은 (hAs)의 값의 크기로 표시될 수 있을 것이다. Figure 9는 정렬 핀-휜 배열에서 휜의 형상에 열전달성능에 미치는 영향을 보여준다. 여기서 As^{*}h^{*}는 휜 단면형상이 원형일 때 의 열전달 성능을 나타낸다.

그림에서 보듯이 타원형 및 날개형의 (hA_s)는 어떤 두께에서 최소값을 가지며, 형상이 원형에 접근함에 따라 원형의 (hA_s)값 에 수렴하고 있다. 또한 휜의 두께비가 0.39 이하에서 열전달 성능은 Eq. 14와 같고, 날개형의 경우가 가장 큼을 알 수 있다.

$$(hA_s)_{circle} < (hA_s)_{e\,llipse} < (hA_s)_{wing} \tag{14}$$

앞서 3.1절과 3.2절에서 언급한 바 와 같이 횐의 형상이 원 형에서 얇은 두께의 날개형 혹은 타원형으로 변할수록 즉, 유 선형으로 변할수록 횐의 표면적(A_s)은 커지고, 반면에 횐의 평 균열전달계수(h_s)는 작아지는데, 두께가 어떤 값 이하가 되면 (A_s)의 중가율이 (h_s)의 감소율 보다 오히려 크게 되어 열전달 계수와 표면적의 곱(hA_s)인 열전달 성능은 더 증가하게 된다. 본 연구의 계산 범위 내에서 보면, 날개형 핀-횐과 타원형 핀-휜은 그 두께가 각각 원형 횐의 단면지름의 약 39%, 약 36% 이하가 되면 원형 휜보다 열전달 성능이 더 우수하였다. 그리고 두께가 원형 횐의 단면지름의 52% 이하부터 날개형 횐의 성능이 타원형 횐의 그것에 비해 더 우수하였다. 본 연구 의 계산 범위 내에서 보면, 날개형이 원형에 비해 약 50% 이 상의 열전달 성능향상을 보였다. 이러한 사실은 핀-횐의 형상 을 적절히 설계함으로써 열전달 성능의 향상과 함께 공기의 순환에 소요되는 펌프입력도 줄일 수 있다는 것을 말해준다.

4. 결 론

본 연구는 정렬 배열된 핀-휜 열교환기에서 날개형 휜의 형 상이 열전달에 미치는 영향을 수치적으로 살펴본 것이다.

본 연구 범위 내에서 결과를 보면, 휜의 두께가 원형 휜의 단 면지름의 36% 이하인 경우 타원형과 날개형 휜의 열전달 성능 이 원형 휜의 그것에 비하여 더 우수하였다. 휜 두께가 20% 이하인 경우 날개형 휜의 열전달 성능이 가장 우수하고, 원형 휜에 비해 50% 이상의 성능향상을 보였다. 반면에 휜의 두께 가 36% 미만인 경우, 원형 휜이 날개형과 타원형에 비하여 열 전달 성능이 우수하였다.

본 연구의 결과는 휜 밀도나 투입공기량의 중가 없이 핀-휜 의 형상 변화만으로도 핀-휜 열교환기의 성능을 크게 향상시 킬 수 있음을 보여준다.

사용기호

- A : 면적 (mm²)
- Cp:비열 (J/kgK)
- H : 윈드터널의 높이 (mm)
- h : 열전달계수 (kW/m^{*}K)
- L : 윈드터널의 길이 (mm)
- p : 압력 (kPa)
- q : 열플럭스 (kW/cm²)
- T : 온도(K)
- t : 핀 두께 (mm)
- V : 속도(m/s)
- W : 윈드터널의 너비 (mm)
- α : Prandtl 수
- κ : 열전도율 (W/mK)

ρ : 밀도 (kg/m³) μ : 점도 (kgm/s)

하첨자

in : 입구

```
s : 표면
```

참고문헌

- Sathe, S., and Sammakia, B., "A Review of Recent Developments in Some Practical Aspects of Air-cooled Electronic Package," *Trans. ASME J. of Heat Transfer*, 120, 830-839 (1998).
- Bar-Cohen, A., "Air-Cooled Heat Sink-Trends and Future Directions," Proc. Advances in Electronic Packaging, Vol. 2, 1827-1828 (1997).
- Kim, Y. H., and Rhee, G. H., "Study on Heat Transfer Enhancement with Variation of Heat Sink Shape in CPU Cooling," *Trans. SAREK*, 15(10), 860-869 (2003).
- Razelos, P., and Satyaprakash, B. R., "Analysis and Optimization of Convective Trapezoidal Profile Longitudinal Fins," *Trans. ASME J. of Heat Transfer*, **115**, 461-463 (1993).
- Nakazato, N., Hirasawa, S., and Mato, T., "Natural Convection Cooling in Vertical Finned Plates in a Cabinet for Communication Equipment," IEICE Trans. on Electronics, Vol. E81-C, No. 3, 421-426 (1998).
- Morrison, A. T., "Optimization of Heat Sink Fin Geometries for Heat Sink in Natural Convection," Proc. of the Intersociety Conference on Thermal and Thermo Mechanical Phenomena in Electro Systems, 145-148 (1992).
- 7. Fluent, FLUENT 6 User's Guide, Fluent Inc., 2001.